

---

# 2012年度 第3四半期 決算説明資料

---

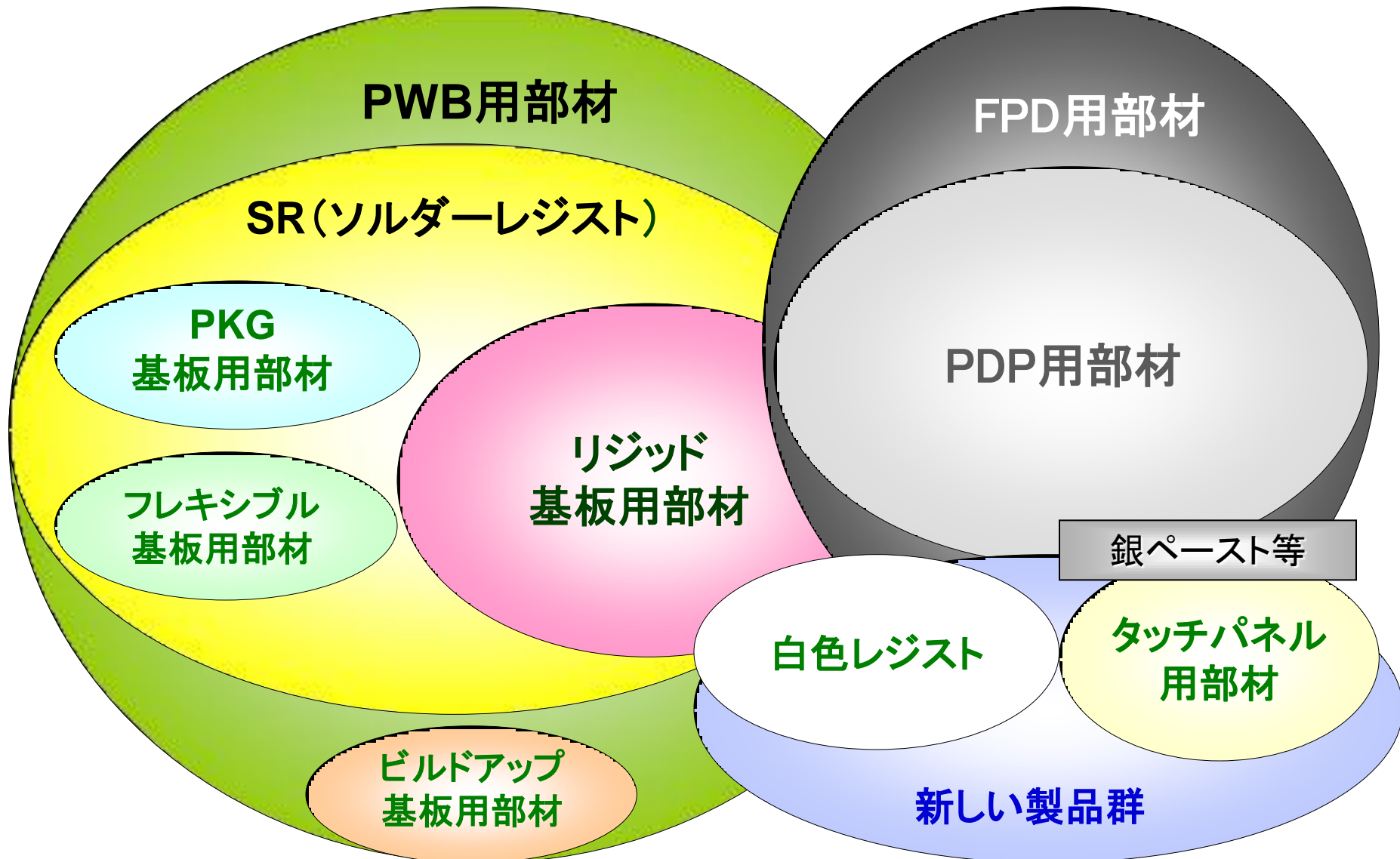
太陽ホールディングス株式会社

2013年2月6日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

# 当社グループの製品分野



用語	内容
PWB用部材 (Printed Wiring Board)	プリント配線板用部材
FPD用部材 (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ用部材
PDP用部材 (Plasma Display Panel)	プラズマディスプレイ・パネル用部材
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト(レジストインキ)
PKG基板用部材 (Package)	モジュール基板

## 2012年度 第3四半期 連結業績

# 12年度 第3四半期業績

(単位:百万円)

項目	11年度 第3四半期 (累計)	12年度 第3四半期 (累計)	増減額	増減率
売上高	30,830	27,669	△3,160	△10.3%
営業利益	3,374	3,485	+111	+3.3%
経常利益	3,344	3,737	+392	+11.7%
四半期純利益	1,911	2,517	+605	31.7%
円・USDレート	79.17	80.42	+1.25	—

## □PWB用部材

- ・売上金額は高機能品の好調により増加
- ・売上数量は前年同期と同水準
- ・売上単価は前年より3%増

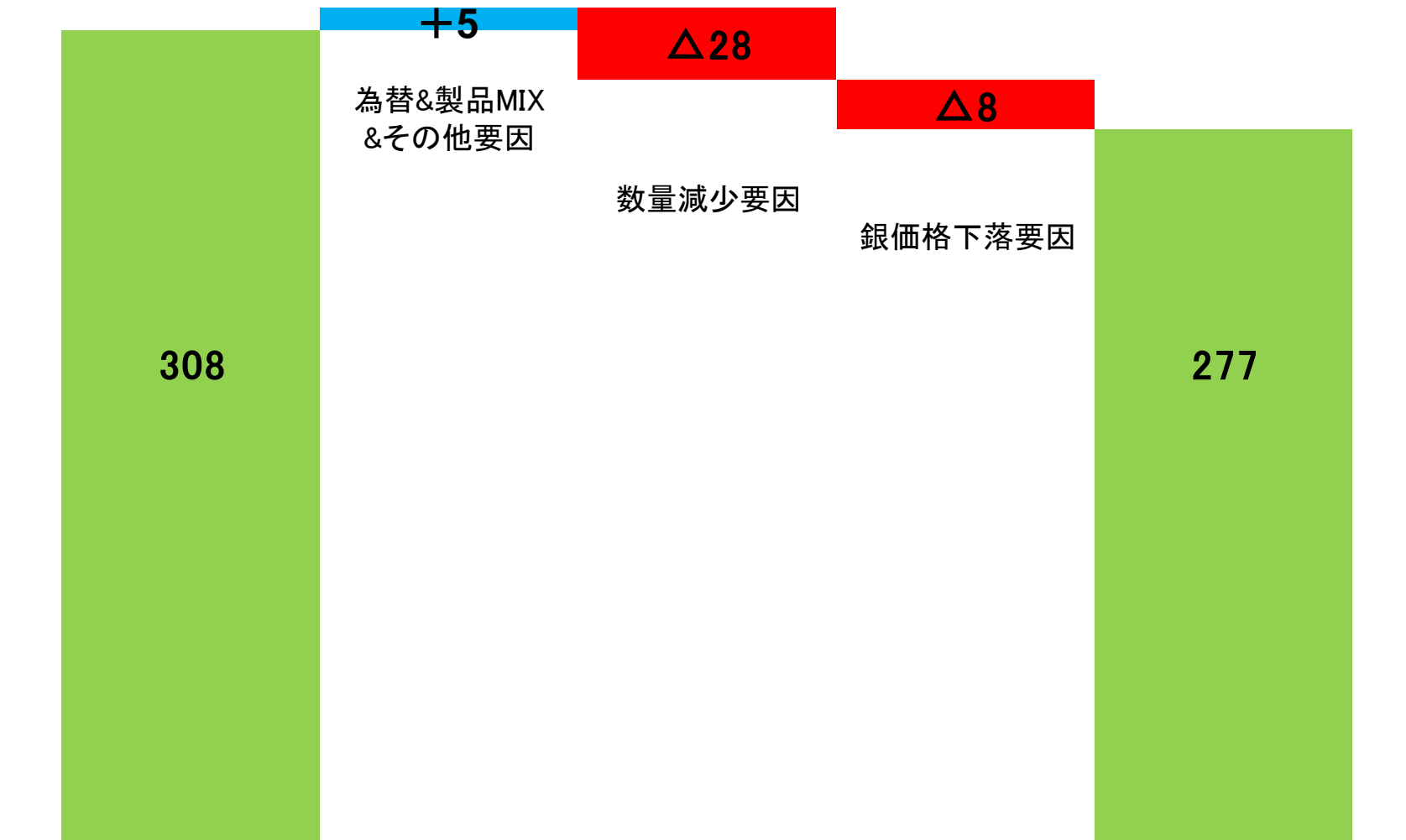
## □FPD用部材

- ・売上数量は市場の縮小などにより前年比大幅減
- ・前期高騰した銀価格が下落したため単価は13%減

# 12年度実績 減収要因(前期比)

## 売上高

(単位:億円)



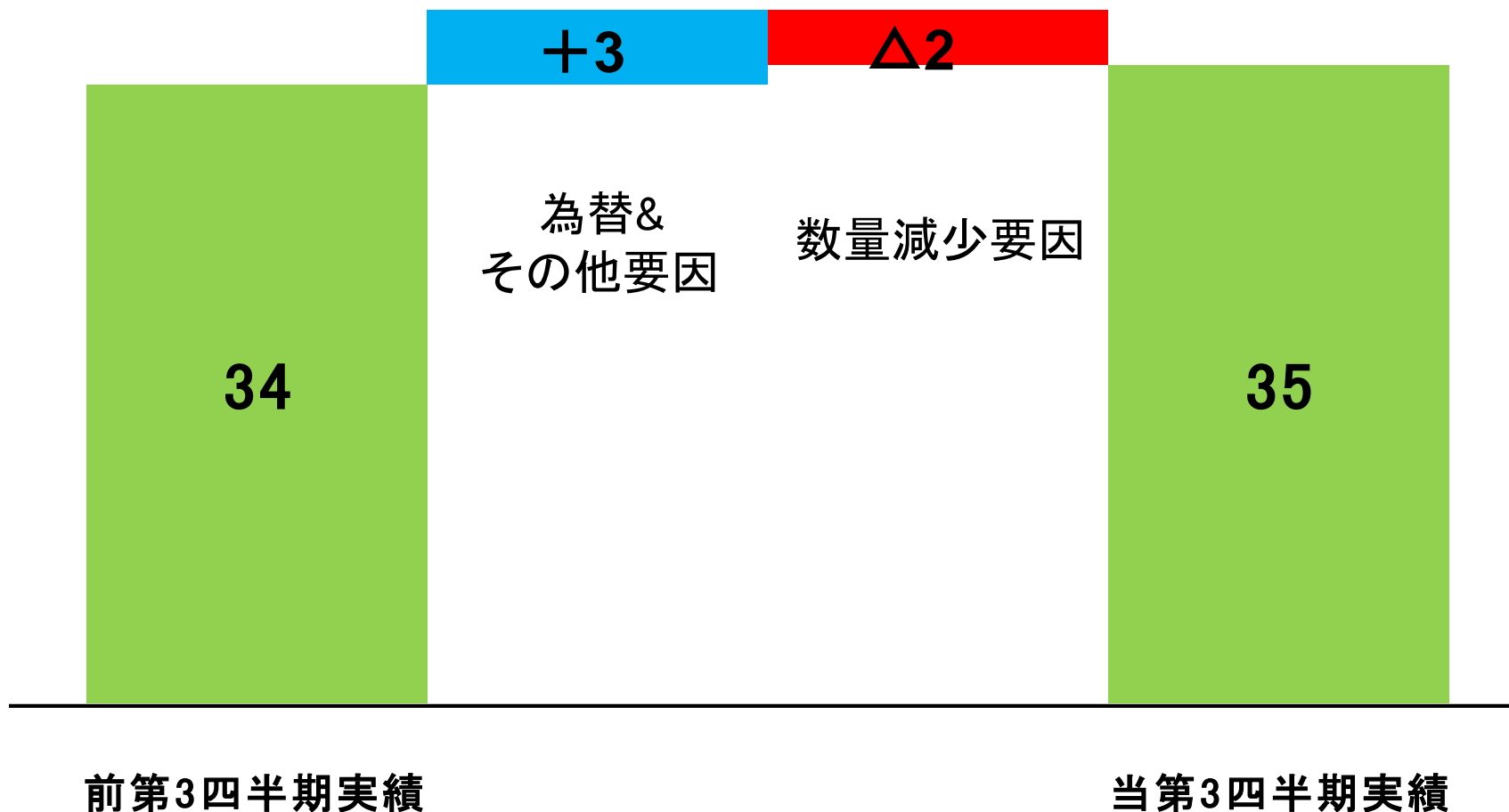
前第3四半期実績

当第3四半期実績

# 12年度実績 増益要因(前期比)

## 営業利益

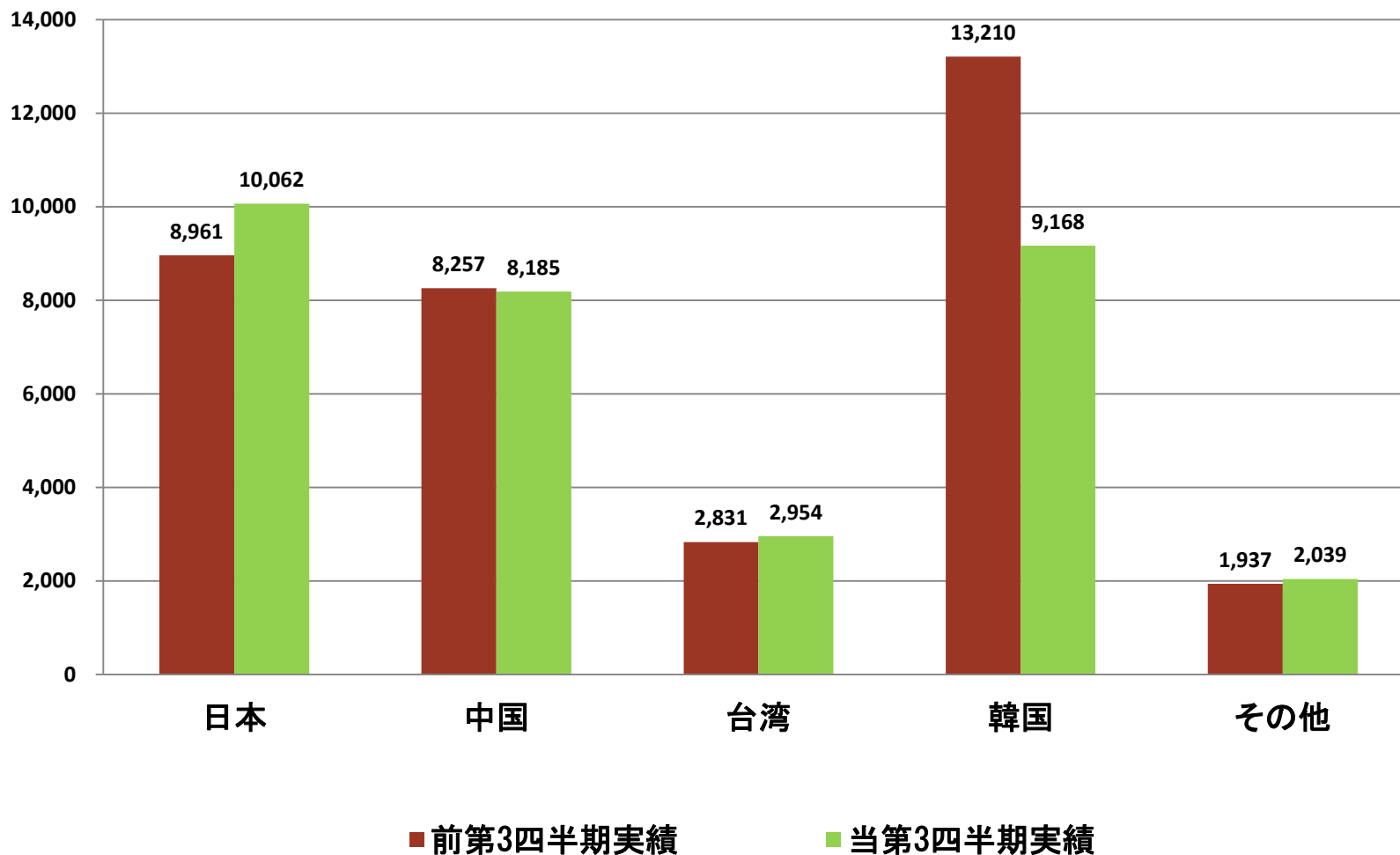
(単位:億円)





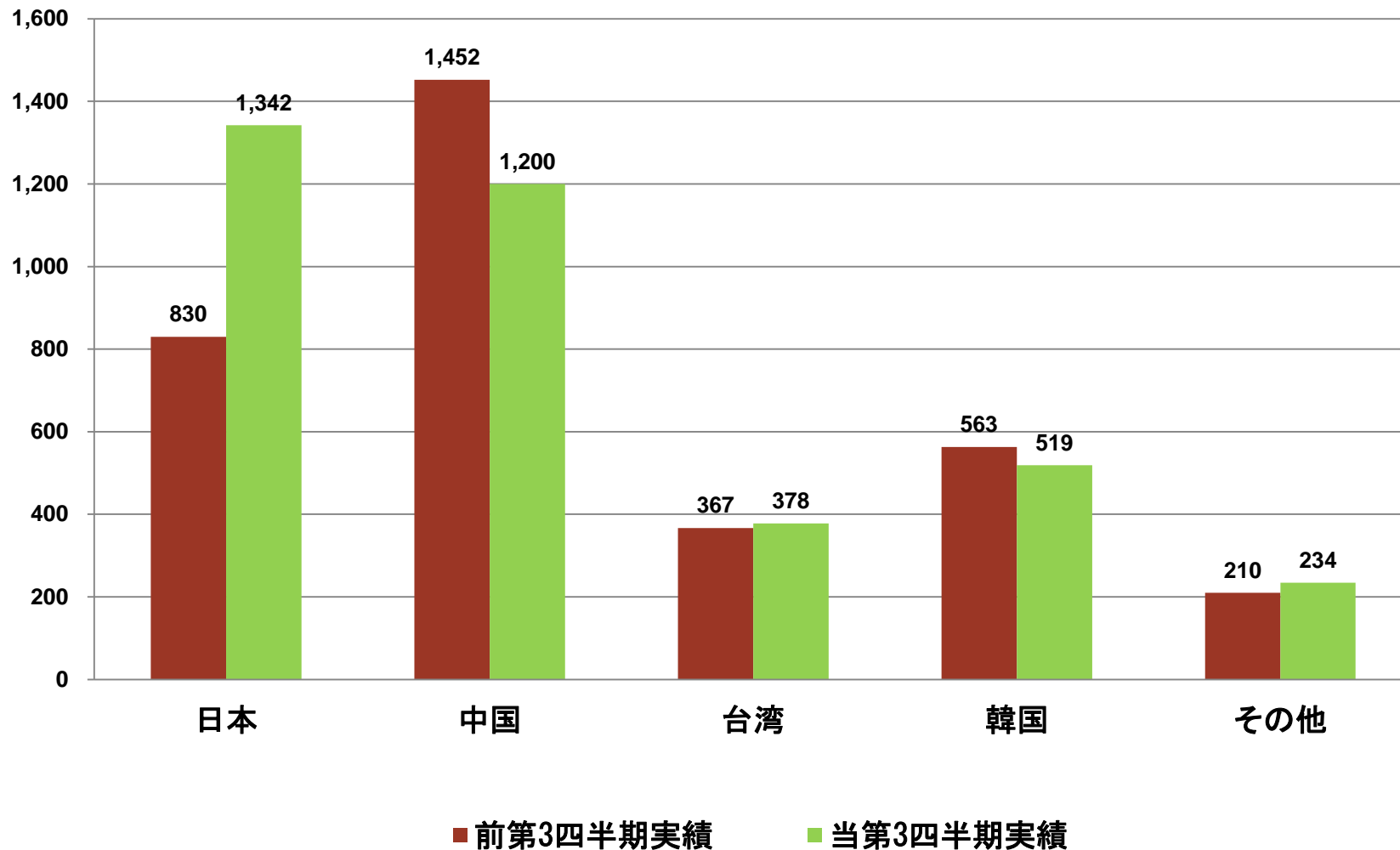
# セグメント別売上高

(単位:百万円)



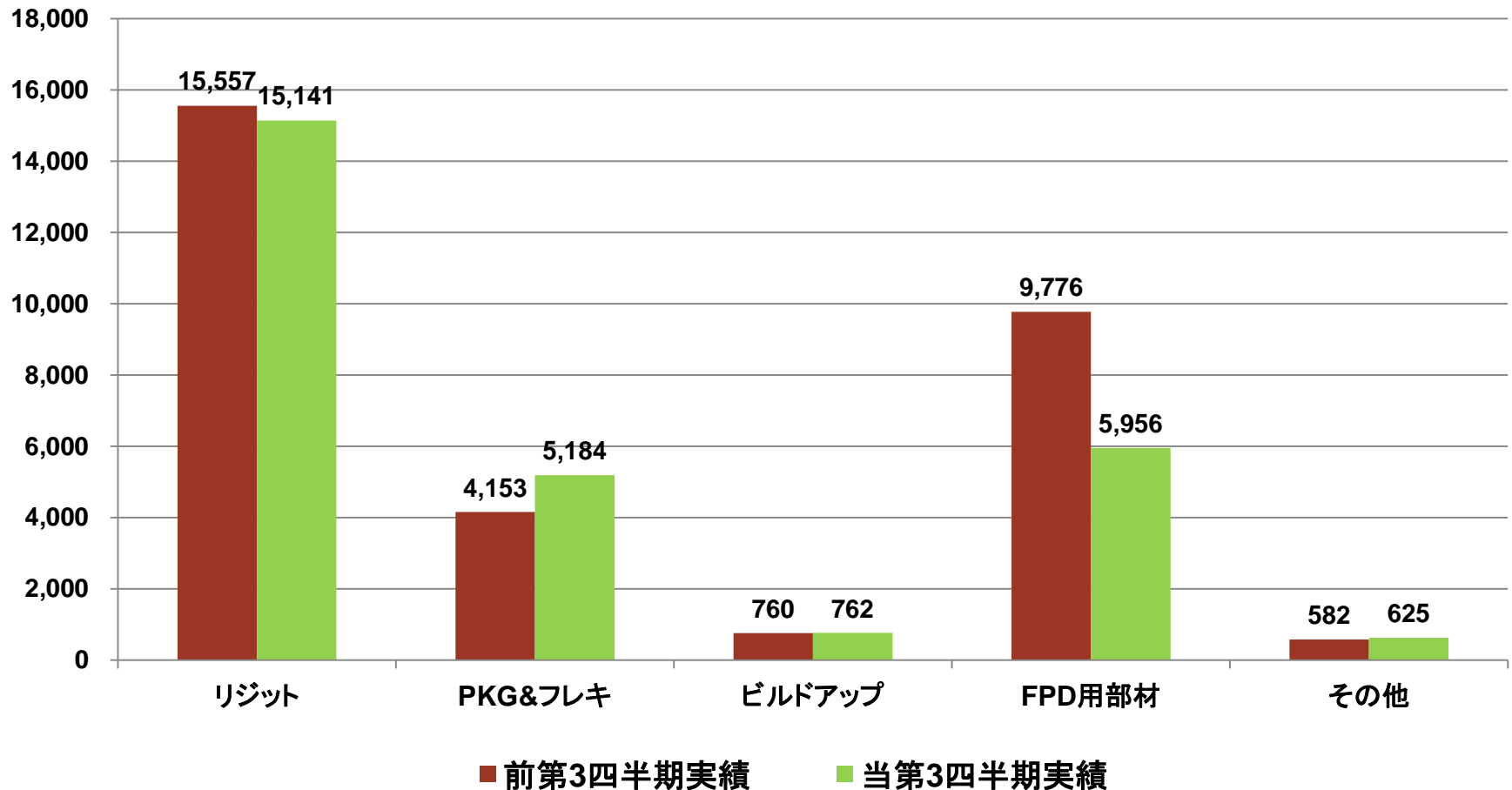
# セグメント利益

(単位:百万円)

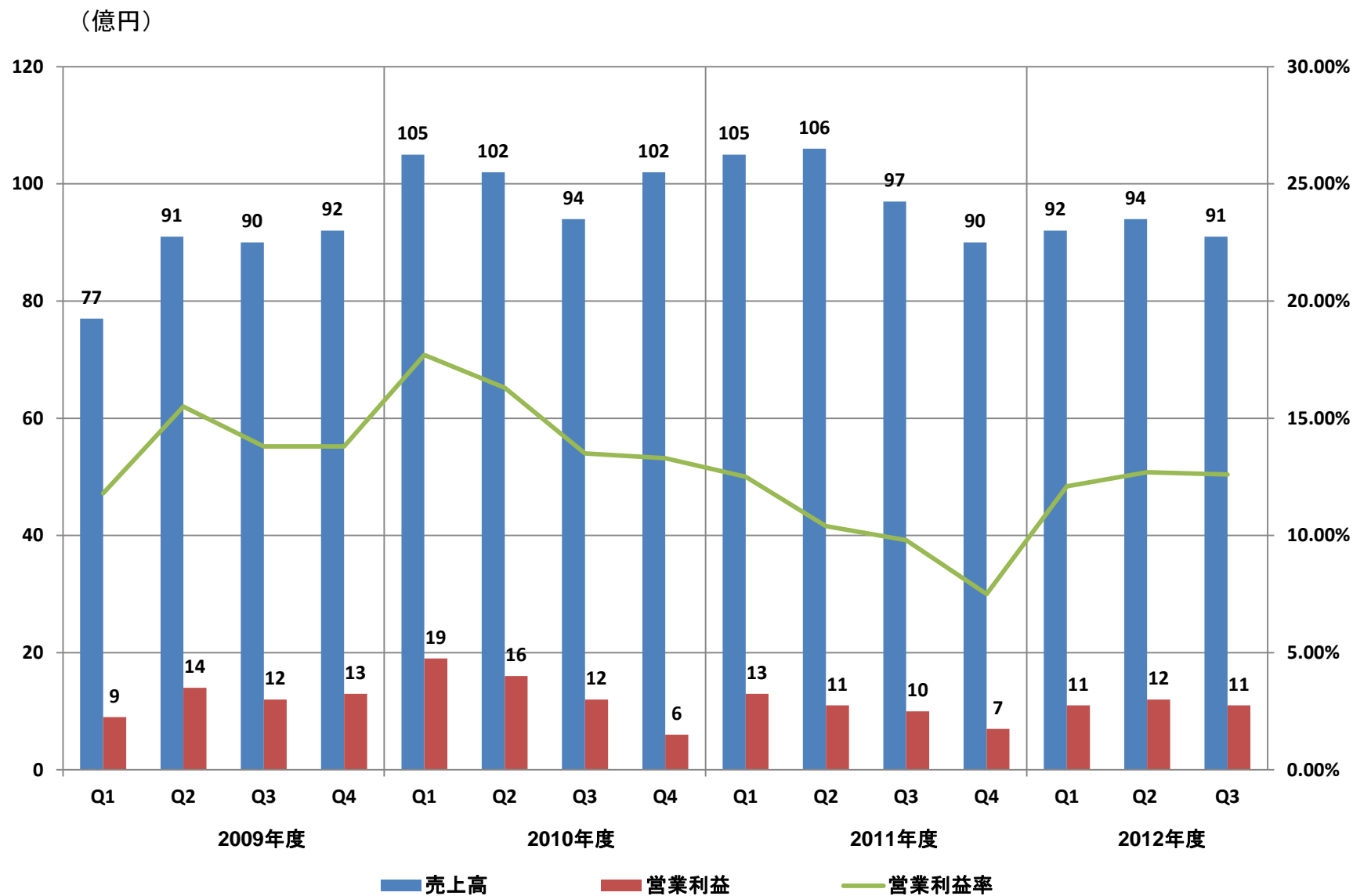


# 製品分類別売上高

(単位:百万円)



# 四半期別の業績推移



# 連結業績の推移及び見通し

(億円)

